

## АО «РТСофт» анонсирует доступность модулей COM Express на базе Intel® Core™/Xeon® E 9-го поколения с 6 ядрами на борту и мощной графикой

АО «РТСофт» и международный холдинг Kontron AG анонсируют старт продаж нового поколения «компьютеров на модуле» в стандарте PICMG COM.0 R3.0 COM Express Type 6 (COMe-bCL6) на базе встраиваемых микропроцессоров 9-го поколения Intel® Core™/Xeon® E (кодовое название – Coffee Lake-H Refresh), выполненных в соответствии с техпроцессом 14++ нм, с коммерческой доступностью не менее 7 лет.

Аппаратура COM Express на базе 9-го поколения Intel® Core™/Xeon® E устанавливает новые стандарты производительности, энергоэффективности, функциональности и защищенности для быстрой разработки самых разнообразных целевых приложений, где крайне важно в соответствии с концепцией SWaP-C минимизировать габариты (size), вес (weight), энергопотребление (power) и стоимость (cost), обеспечив при этом высокие показатели надежности.



В дополнение к уже имеющимся процессорам 8-го поколения модуль COMe-bCL6 теперь доступен на процессорах 9-го поколения. Особого внимания из них заслуживают модули COMe-bCL6 на процессорах Intel с 6 ядрами на борту и теплопакетом всего 25 Вт:

- ▶ Intel® Xeon® E-2276ML (6 × 2,0 ГГц, GT2, CM246, 25 Вт);
- ▶ Intel® Core™ i7-9850HL (6 × 1,9 ГГц, GT2, QM370, 25 Вт).

Новые модули опционально обеспечивают поддержку до 128 ГБ DDR4 2666 ECC со скоростью до 41,8 Гб/с, имеют опциональный бортовой NVMe SSD до 1 ТБ, поддерживают работу трех независимых графических интерфейсов (DisplayPort/HDMI/eDP) с разрешением до 4096 × 2304 @ 60 Гц и аппаратным кодированием/декодированием мультимедийного контента, включая HEVC 10 бит.

Разработчики собственного целевого оборудования на основе модулей COMe-bCL6 по досто-

инству оценят удобство создания подсистем ввода/вывода на базе гибко конфигурируемого PCI Express 3.0, функциональность четырех USB 3.1 с поддержкой до 10 Гб/с Type C, развитость BIOS/EFI AMI Aptio V, поддержку Intel Optane и великолепные возможности архитектуры 9-го поколения по администрированию, оптимизации, кибербезопасности и совместимости.

Модули COMe-bCL6 доступны в трех рабочих температурных диапазонах эксплуатации: от 0 до +60 °С, от –25 до +75 °С и от –40 до +85 °С, что гарантирует большой набор преимуществ по созданию совместимого оборудования самого широкого назначения.

Использование новых модулей обеспечивает разработчикам максимум свободы и удобства в выборе операционных систем класса Windows, Linux, QNX, VxWorks, LynxOS и современных инструментальных средств разработки для реализации практически всех важнейших концепций применения передовой вычислительной техники подобного класса: IoT, IIoT, MIIoT и принципов конструирования ответственной COTS-аппаратуры.

Применение модулей COMe-bCL6 позволяет быстро и бюджетно вывести на рынок конкурентоспособные конечные решения мирового уровня для промышленных, транспортных, телекоммуникационных, медицинских и иных приложений. Модули доступны для заказа. Планируемый срок коммерческой доступности – не менее 7 лет, что делает их великолепной платформой для разработки любых критичных к надежности и длительности жизненного цикла приложений.

Модули COMe-bCL6 на базе 9-го поколения Coffee Lake Intel® Core™/Xeon® E будут валидированы для серийных отечественных промышленных платформ BLOK Industrial и BLOK Rugged в течение 1-го квартала 2020 года. Серийные образцы линеек BLOK для новых стартапов на базе Xeon E и Core i7 8-го поколения доступны для заказа уже сейчас. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте [www.kontron.com](http://www.kontron.com) и в офисах компании «РТСофт» ([www.rtsoft.ru](http://www.rtsoft.ru)), стратегического партнера холдинга Kontron в России и странах СНГ.

АО «РТСофт», г. Москва,  
тел.: +7 (495) 967-1505,  
e-mail: [sales@rtsoft.msk.ru](mailto:sales@rtsoft.msk.ru),  
сайт: [lauterbach.rtsoft.ru](http://lauterbach.rtsoft.ru)